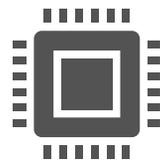




半導体リスキリング研修 パワー半導体の基礎・半導体実装概論



概要

パワー半導体の基礎から応用、最新チップ・パッケージ技術・製造工程を体系的に学ぶとともに、先端半導体実装技術についても、接合・封止・サブストレート・信頼性など多角的視点から進化と最新動向を幅広く理解できます。基礎知識習得に最適です。

日程・定員・受講料

令和7年8月22日（金）・9月26日（金）

日程	内容	定員	受講料
8月22日（金） 10：00～17：00	パワー半導体の基礎 ～重点ポイント解説版～ ・パワーエレクトロニクスとパワー半導体 ・パワー半導体のチップ技術 ・モーター実験 ほか	35名	無料
9月26日（金） 10：00～17：00	半導体実装概論 ・微細接合技術 ・樹脂封止、絶縁技術 ・パッケージ信頼性 ほか	35名	無料

※ 各日9：30から受付開始

会場

大分県産業科学技術センター 第1研修室
(大分市高江西 1-4361-10)

講師

パワー半導体の基礎

三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所

応用技術統括 山田 順治 氏

半導体実装概論

大阪大学フレキシブル3D実装協働研究所

所長／特任教授／名誉教授 菅沼 克昭 氏

お申込み・お問合せはこちら

申込方法

URL、または二次元コードからアクセスの上、お申込みください

<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/r7-semi>

申込締切

令和7年8月18日（月）

お問合せ

大分県産業科学技術センター 工業化学担当 安部、上野、安藤
TEL：097-596-7101、E-mail：i-chem@oita-ri.jp



※ 当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

※ お申込みいただいた内容は、当センターが開催するセミナーの運営管理に利用し、他の目的で利用することはありません。

